產業鏈追蹤分析報告

美達科技(6735) × 旺矽集團(6223) × 博磊(3581)
光通訊訂單合作可能性推論

分析日期：2026 年 5 月 12 日

【免責聲明】本報告內容僅為個人基於公開資訊之研究推論，不構成任何投資建議。文中涉及未經公司正式證實之推測，均以「或許」、「可能」、「推測」等字眼標示。投資人應獨立判斷，審慎評估風險。

一、研究動機

美達科技（6735）近期股價出現劇烈漲勢，自 2026 年 4 月下旬起連續拉出多根漲停板，股價從約 60 元區間一路飆升至 135 元以上。市場將其漲勢歸因於同時卡位 CoWoS 封裝檢測、CPO 光通訊以及衛星訊號等三大熱門題材。

在追查美達科技年報重要契約時，發現其與長洛國際股份有限公司存在代理銷售產品之經銷合約（合約期間 114/12/01～115/12/31，目前仍有效）。進一步查證後發現，長洛國際的全部董監事法人代表均為旺矽科技，確認長洛國際為旺矽 100% 子公司。而博磊科技（3581）同樣隸屬旺矽集團，且博磊股價近期走勢亦出現類似的暴漲趨勢。這些線索串聯起來，引發了本次追蹤分析。

二、關係鏈梳理：已確認之公開事實

項目	內容	資料來源
長洛國際	旺矽科技 100% 持股子公司。董事長葛長林、全部董監事法人代表皆為旺矽科技。	經濟部商工登記、旺矽官網里程碑
博磊科技	隸屬旺矽集團，「旺矽博磊科技集團」為公開可查之集團架構。	透明足跡網站、Yahoo 股市關係企業
美達 ↔ 長洛	美達年報「重要契約」揭露與長洛國際有經銷合約，主要內容為代理銷售產品，合約期間 114/12/01～115/12/31。	美達科技 114 年度年報
旺矽光通訊布局	旺矽技術版圖涵蓋矽光子晶片（PIC、EIC）及光引擎模組測試。2025 年 8 月與 Lightium、Axiomatic_AI 簽署 MoU，開發光子晶片測試方案。	旺矽官網、經濟日報報導
美達本業	半導體類比暨混合訊號積體電路測試儀器製造商，卡位 CoWoS 封裝檢測、CPO 光通訊、衛星訊號題材。	ETtoday 財經雲報導

表 1：已確認之公開關係鏈（資料截至 2026/05/12）

三、財務數據觀察：合約負債同步異常跳升

比對美達科技與博磊科技的資產負債表，兩家公司在 115 年第一季（2026 年 Q1）的合約負債均出現顯著跳升，此項目通常代表客戶預付款項，意味著有新訂單或大額訂單進入。

3.1 美達科技（6735）關鍵數據變化

會計項目	115 年 03 月 31 日	114 年 12 月 31 日	變化幅度
合約負債（流動）	71,534 仟元	13,056 仟元	+448%
應付帳款	34,174 仟元	13,959 仟元	+145%
應收帳款淨額	114,064 仟元	124,255 仟元	-8%
存貨	164,555 仟元	170,485 仟元	-3%

表 2：美達科技資產負債表關鍵項目變化（單位：新台幣仟元）

美達合約負債從 114/12 的 1,305.6 萬大幅跳升至 115/03 的 7,153.4 萬，增幅達 448%。同時應付帳款亦倍增，顯示公司正同步向上游大量採購，推測有大額訂單需求正在執行中。3 月單月營收 4,386.3 萬元、年增 299.59%，公司公告備註為「本月訂單需求增加」。

3.2 博磊科技（3581）關鍵數據變化

會計項目	115 年 03 月 31 日	114 年 12 月 31 日	變化幅度
合約負債（流動）	320,146 仟元	191,959 仟元	+67%
應付帳款	186,496 仟元	169,986 仟元	+10%
應收帳款淨額	405,948 仟元	392,093 仟元	+4%
存貨	601,160 仟元	523,862 仟元	+15%

表 3：博磊科技資產負債表關鍵項目變化（單位：新台幣仟元）

博磊合約負債同期亦從 1.92 億跳升至 3.2 億，增幅 67%，且存貨增加 15%。兩家公司的合約負債在同一季度同步出現異常增長，或許暗示背後有共同的產業需求驅動，但也可能是各自業務獨立成長的巧合。

四、股價走勢觀察

從股價走勢比對圖可以觀察到以下現象：



圖 1：美達科技（6735）vs 博磊（3581）日線走勢比對圖（截至 2026/05/12）

- 美達科技（6735）：自 2026 年 4 月下旬開始，股價從 60 元附近暴漲，至 5 月 12 日收盤 135.5 元（當日漲幅 +8.4%），半年漲幅達 68.13%。成交量從平日數百張暴增至每日逾 460 張以上，已被列入處置股票分盤交易。
- 博磊科技（3581）：幾乎在同一時間段（2026 年 4 月中下旬）啟動主升段，從約 60 元區間急拉至 5 月 12 日的 234 元，半年漲幅達 85.54%。兩檔股票的啟動時間點與加速時間段高度吻合。
- 旺矽科技（6223）：同期間股價亦處於上升趨勢中，作為母集團公司，受惠於矽光子/光通訊測試設備需求升溫，近期維持相對強勢。

兩家公司股價啟動時間高度重疊這一現象，有可能反映出市場認為兩者共同受惠於某一相同的產業趨勢或訂單題材，但也不排除是整體光通訊族群輪動帶動的結果。

五、合理推論與假設

綜合以上公開資訊，可以建構出以下尚待驗證的推論假設：

假設一：旺矽集團透過長洛國際轉單美達

旺矽集團在矽光子/光通訊測試領域取得新訂單後，或許透過子公司長洛國際，將部分類比/混合訊號 IC 測試儀器的需求委託美達科技代工或採購其產品，從而帶動美達科技的合約負債與營收暴增。長洛國際與美達之間的經銷合約（代理銷售產品）提供了此一合作的制度性基礎。

假設二：集團內協同出貨光通訊訂單

旺矽集團旗下的博磊科技負責部分光電/半導體設備生產，而美達科技提供配套的測試儀器。在大型光通訊或矽光子晶片測試專案中，有可能需要探針台（旺矽）、自動化設備（博磊）與測試儀器（美達）的整合方案，因此三者可能形成協同出貨的關係。

假設三：獨立成長的巧合

也必須考慮另一種可能：美達與博磊各自受惠於不同的客戶或訂單，合約負債同步增長只是因為 2026 年 Q1 半導體/光通訊產業整體需求回溫。兩家公司的股價同步上漲，可能純粹是光通訊概念股輪動效應。在缺乏公司正式披露的情況下，此可能性同樣不能排除。

六、產業背景：光通訊/矽光子的爆發期

本次推論之所以具有一定合理性，與當前光通訊/矽光子產業的爆發性成長密切相關：

- 2026 年被產業界視為 CPO（共封裝光學）商轉元年，台積電 COUPE 技術、NVIDIA 及 Broadcom 均加速布局。
- 全球 800G 以上光收發模組預計 2026 年達近 6,300 萬組，年增 2.6 倍。
- 旺矽科技已被列為 SEMI 矽光子產業聯盟成員，且於 2025 年 8 月與 Lightium AG 簽署 MoU，開發 AI 驅動的光子晶片測試方案。
- 美達科技被媒體點名同時卡位 CoWoS 封裝檢測、CPO 光通訊與衛星訊號三大題材。

在此產業背景下，測試設備/儀器廠商的訂單同步增長具有產業邏輯上的合理性。

七、結論與注意事項

項目	確認程度	說明
長洛國際為旺矽子公司	已確認	公開登記資料可查證
博磊為旺矽集團企業	已確認	公開集團架構可查證
美達與長洛有經銷合約	已確認	美達年報重要契約揭露
美達、博磊合約負債同步跳升	已確認	115Q1 資產負債表數據
美達營收暴增來自旺矽/光通訊訂單	推測	尚無公司正式披露，僅為合理假設
三者協同出貨光通訊方案	推測	產業邏輯合理，但無直接證據
股價同步啟動反映共同題材	推測	也可能是族群輪動效應

表 4：各項推論之確認程度總覽

本報告所建構的推論鏈——「旺矽集團透過子公司長洛國際與美達科技建立經銷關係，並可能在光通訊/矽光子產業爆發期協同出貨」——在產業邏輯上具有合理性，且有公開資訊作為部分支撐。然而，核心假設（美達營收暴增是否直接來自旺矽集團訂單）目前仍屬推測，有待後續公司法說會、股東會或進一步財報揭露來驗證。

後續觀察重點：

- 美達科技股東會或法說會是否揭露主要客戶或訂單來源
- 旺矽集團在光通訊測試設備的出貨動態與營收結構變化
- 博磊科技後續營收是否持續放大，及其產品組合是否轉向光通訊
- 長洛國際與美達的經銷合約到期後是否續約或擴大合作範圍